

集積回路 (Integrated Circuit, IC) は、特定の複雑な機能を果たすために、多数の素子を一つにまとめた電子部品で、主に半導体で構成された電子回路が複数の端子を持つ小型パッケージに封入されています。この電子部品はコンピュータ、車両の各種制御など多くの分野で使用されておりその信頼性は非常に重要な性能の一つです。

本ソリューションでは、MSCが提供するソフトウェアを用いたICパッケージの信頼性解析に関連する最新情報をご紹介します。

内容

- モデリング技術
 - ・ SimXpertによるCAEモデル作成の自動化
- 接触定義の自動化
- ソルバー技術
 - ・ 並列計算による大規模解析の高速化技術
 - ・ き裂進展解析
 - ・ 基盤のそりをシミュレートするキュアリング解析
 - ・ 電気-熱-構造の連成解析
 - ・ 機構解析と有限要素法解析の統合
- CAEの実行環境関連技術
 - ・ SimManagerによる材料データの管理
 - ・ SimManagerによるCAEデータ・プロセスの管理



対象企業/対象者

- 対象企業
 - ・ PC、LED、携帯電話、車載用電子部品等の製造を行っている企業
- 対象者
 - ・ ICパッケージの信頼性設計部署の責任者、エンジニア
 - ・ ICパッケージを用いた製品設計を行っていらっしゃるエンジニア、責任者など

エムエスシーソフトウェア株式会社

E-mail: mscj.market@mscsoftware.com

本 社 〒160-0023 東京都新宿区西新宿1丁目23番7号 新宿ファーストウェスト
 TEL.03-6911-1200 FAX.03-6911-1201

大阪営業所 〒532-0003 大阪市淀川区宮原3丁目5番36号 新大阪トラスタワー3F
 TEL.06-6393-0701 FAX.06-6393-0702

名古屋営業所 〒450-0001 名古屋市中村区那古野1丁目47番1号 名古屋国際センタービル
 TEL.052-589-8505 FAX.052-561-0339